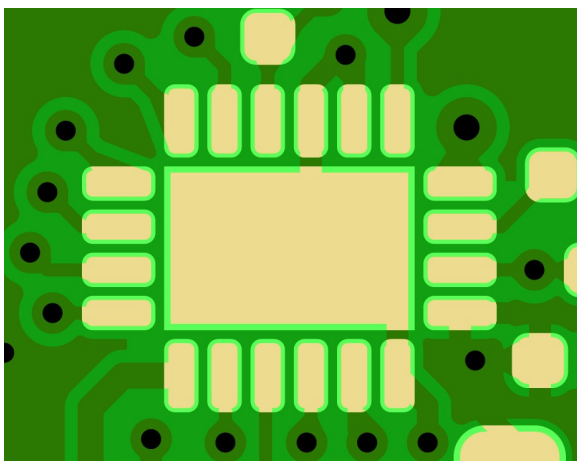


Zamaskované prokovené otvory

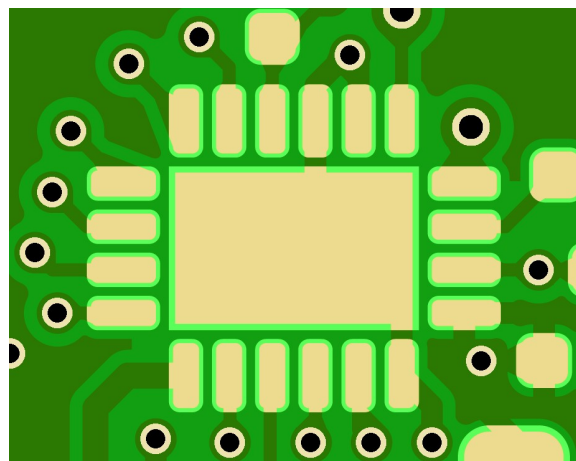
U zamaskovaných prokovených otvorů o průměru 0,3 mm a menší, dochází k náhodnému hromadění náboje na povrchu plošek a k jejich neozlacení či nepocínování, což způsobuje vady povrchových úprav a vysokou zmetkovitost výroby, které nemůžeme nijak ovlivnit. Může dojít také k uzavření chemie uvnitř prokovu a snížení spolehlivosti propojení.

Abychom tomuto předešli, je nutné zvolit jednu z těchto variant:

- 1) Odmaskování prokoveného otvoru tak, aby jím mohly volně protékat procesní kapaliny při výrobě a oplachu. Z toho důvodu musí být všechny prokovy oboustranně odmaskovány (průměr otvoru +100um)
Tuto úpravu by měl mít zákazník již ve výrobních datech, nebo bude udělána při zpracování dat v Gatema PCB.
Pokud s touto úpravou zákazník nesouhlasí, musí to specifikovat v objednávce, ale bere tím na sebe riziko nižší kvality finálního povrchu spojeného se zamaskovanými prokovy nebo riziko zhoršené spolehlivosti prokovených otvorů.

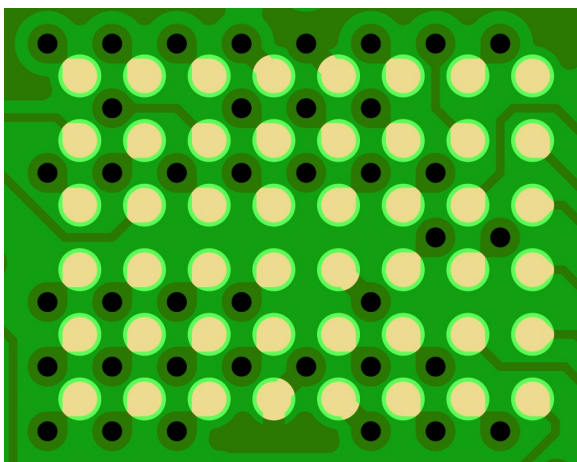


Via pod maskou před úpravou

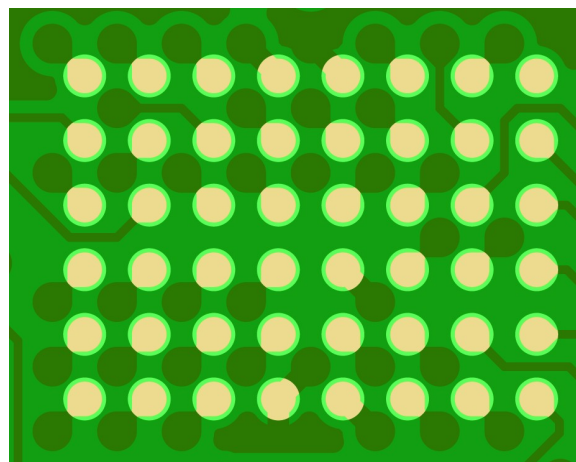


Odmaskované Via po úpravě

- 2) Pokud zákazník požaduje zamaskované prokovy, doporučujeme použít via filling + přeplátování IPC-4761 typ VII.



BGA via pod maskou před zaplněním a přeplátováním



BGA via pod maskou zaplněné a přeplátované